



DeepCleave™ Module

成丝切割模块

成丝切割（DeepCleave™）模块致力于为厚玻璃激光切割提供完整的光学解决方案，无需外部高数值孔径（NA）的物镜或其他高成本光学元件。

具有超短红外（IR）脉冲的激光玻璃切割技术正迅速成为高通量玻璃加工的关键。因为激光能量需要紧聚焦于一点并在玻璃深度维度均匀分布，因此使用这种技术切割厚玻璃（> 500um）正面临着独特的挑战。

为了帮助我们的客户克服这一挑战，**Holo/Or** 很自豪地推出 DeepCleave™ 模块，这是一种玻璃切割光学模块，在大焦深（空气中 > 1mm）上具有紧密聚焦（< 2um 光斑）的特点。其中，聚焦点相当于 0.35 倍的物镜数值孔径（NA），非常适合切割像平板这样的厚玻璃。

这种独特的细长聚焦光学元件是为了提高激光玻璃切割效率而开发的，并且其与 SM1 兼容，可轻松的集成到您的激光机中。

SPECIFICATIONS RANGE 参数范围

Wavelengths 波长	1030nm, 1064nm, 以及其它定制需求
Beam Mode 光束模式	单模 $M^2 < 1.3$
Input Beam Diameter 入射光束直径 (exp^{-2})	6mm (+/-10%)
Optical elements Material 光学元件材料	Fused Silica 石英玻璃
Coating 涂层	所有的光学元件都是 AR 涂层
Depth of Focus in Air 在空气中的聚焦深度	~1 mm
Waist Diameter 束腰半径 (exp^{-2})	1.8 um
Working Distance 工作距离	7.4 mm
Efficiency 效率	>93%
Dimensions 外形尺寸	直径 30.5 mm * 长度 106 mm
Mounting Thread 安装螺纹	SM1, SM05 external

